

<<电子工艺及电子工程设计>>

图书基本信息

书名：<<电子工艺及电子工程设计>>

13位ISBN编号：9787810128735

10位ISBN编号：7810128736

出版时间：1999-7

出版时间：北京航空航天大学出版社

作者：汤元信 元学广 刘元法

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子工艺及电子工程设计>>

内容概要

该书是在多年教学实践的基础上，为解决电气类、电子工程类等专业的《电子工艺实习》和《生产实习》之用而编写。

全书包括常用电子材料、安全用电、接地与屏蔽、电子元器件、焊接技术、印制电路板的设计与制作、工业设计与安装技术、产品开发与技术文件共八章。

该书涉及面广、实用性强、重点突出。

对代表着电子技术发展方向的表面安装技术（SMT）和在线可编程逻辑器件（ISPLD）以及当前国内外积极推行的产品“质量

<<电子工艺及电子工程设计>>

书籍目录

- 第一章 常用电工材料
- 第二章 安全用电
- 第三章 电子线路中的接地与屏蔽
- 第四章 电子元器件
- 第五章 焊接技术
- 第六章 印刷电路板设计与制作工艺
- 第七章 工业设计与安装技术
- 第八章 产品开发和技術文件
- 主要参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>